



株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)  
Ferrotec Corporation Code-No.6890(JASDAQ)

2005年12月1日  
Dec. 01, 2005

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method		1,2
2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)		3
3. 連結貸借対照表(負債・資本の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities,Minority interests and Shareholders'equity)		4
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income		5
5. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)		6
6. 期初計画と実績との差異 Review in the first half		7
7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)		8
8. 期初計画と修正計画との差異(下期) Outline of the revised plan (The second half)		9
9. 期初計画と修正計画との差異(通期) Outline of the revised plan (The accounting period)		10
10. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows		11
11. 主要製品の売上推移 Change in sales of main products (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております/Entry amount cuts less than one million yen and be displaying)		12

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。  
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。  
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.

We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.

Unless otherwise stated, estimates or forecasts are solely those of our company as of the above-mentioned date and subject to change without notice.

We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.

This report isn't intended for the use of private investors.

# 1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

## 連結子会社16社 Consolidated Subsidiaries(16)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZHOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals, Thermo-electric Modules, CMS	2,545百万円 2,545million yen	99.9%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferro Fluid, Thermo-electric Modules, CMS	2,079百万円 2,079million yen	100.0%
杭州日磁科技工業園産業開発有限公司 HANGZHOU NIPPON-MAGNETICS SCIENCE INDUSTRY PARK DEVELOPMENT CO.,LTD.	中国 China	その他 Others	650百万円 650million yen	100.0%
上海漢虹精密機械有限公司 SHANGHAI HANHONG PRECISION MACHINERY CO.,LTD.	中国 China	工作機械 Machine assemble	2,820千ドル \$2,820 thousand	100.0%
杭州和源精密工具有限公司 HANGZHOU WAGEN PRECISION TOOLING CO.,LTD.	中国 China	鋸刃 Saw blade	264百万円 264million yen	100.0%
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals, Quartz	1,300千シンガポールドル 1,300 thousand Singapore dollar	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	24,966千ドル \$24,966 thousand	100.0%
Ferrotec Investments,LLC	米国 USA	その他 Others	350千ドル \$350 thousand	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	その他 Others	511千ユーロ 511thousand euro	100.0%
SCTB NORD	ロシア Russia	サーモモジュール Thermo-electric Modules	4,145千ユーロ 4,145 thousand euro	95.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs, Others	225百万円 225million yen	100.0%
(株)フェローテッククオーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウエハ Silicon products, CMS	181百万円 181million yen	100.0%

**連結子会社16社 Consolidated Subsidiaries (16)**

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
アリオンテック(株) ALIONTEK CORPORATION	日本 Japan	石英 Quartz	93百万円 93million yen	44.0%
(株)テクノツーリングシステム Techono Tooling Systems Co., Ltd.	日本 Japan	切削加工用工具 Precision tool	50百万円 50million yen	69.0%
(株)バイオトレンド Bio Trend Corp.	日本 Japan	その他 Others	50百万円 50million yen	100.0%

\* アリオンテック(株)は商法上の子会社ではないが、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める連結子会社。

**持分法適用会社 6社 Company Accounted for by the Equity method (6)**

持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method				
ダイヤセルテック(株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	320百万円 320million yen	18.4%
杭州菱日科技有限公司 (ダイヤセルテックの100%子会社) HANGZHOU LINGRI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	350百万円 350million yen	18.4% (間接所有)
上海博力導国際貿易有限公司 Shanghai Broad International Trading Co.,Ltd.	中国 China	洗浄 cleaning	50百万円 50million yen	60.0%
上海普林客国際貿易有限公司 Shanghai Plating International Trading Co.,Ltd.	中国 China	メッキ Plating	30百万円 30million yen	70.0%
上海庄田国際貿易有限公司 Shanghai Shoda International Trading Co.,Ltd.	中国 China	工作機械 Machine assemble	200千ドル \$ 200 thousand	50.0%
杭州騰和科技有限公司 HANGZHOU TENGHE TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	ソフトウェア開発 Software development	1,082千元 1,082thousand RMB	100.0%

## 2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	05/3		05/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期末比 YOY	
<b>流動資産</b>	<b>Current assets</b>	<b>12,599</b>	<b>41.9</b>	<b>14,276</b>	<b>43.4</b>	<b>1,677</b>	<b>13.3</b>	1. 主なたな卸資産 真空シール 551百万円 石英 678百万円 シリコンウエーハ 488百万円 2. その他の増加要因: 1年内償還予定社債296百万円 主に単結晶引上炉等の部品購入前渡金239百万円 有 価証券売却に関わる未収入金171百万円等の計上によ
現金及び預金	Cash and Deposits	3,188	10.6	3,759	11.4	571	17.9	
受取手形・売掛金	Notes and accounts receivable	5,065	16.9	4,879	14.8	△ 186	△ 3.7	
たな卸資産	Inventories	2,922	9.7	3,383	10.3	461	15.8	
その他	Other assets	1,575	5.2	2,364	7.2	789	50.1	
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	△ 153	△ 0.5	△ 111	△ 0.3	42	△ 27.5	
<b>固定資産</b>	<b>Fixed assets</b>	<b>17,441</b>	<b>58.1</b>	<b>18,582</b>	<b>56.6</b>	<b>1,141</b>	<b>6.5</b>	3. 有形固定資産増加の要因: 主に中国杭州子会社の 第2工場の完成により増加
<b>有形固定資産</b>	<b>Tangible fixed assets</b>	<b>11,190</b>	<b>37.3</b>	<b>12,050</b>	<b>36.7</b>	<b>860</b>	<b>7.7</b>	
建物・構築物	Building and Structures	3,047	10.1	4,011	12.2	964	31.6	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	3,608	12.0	4,088	12.4	480	13.3	
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	955	3.2	1,052	3.2	97	10.2	
土地	Land	2,552	8.5	2,548	7.8	△ 4	△ 0.2	
建設仮勘定	Construction in progress	1,027	3.4	348	1.1	△ 679	△ 66.1	
<b>無形固定資産</b>	<b>Intangible fixed assets</b>	<b>2,642</b>	<b>8.8</b>	<b>3,242</b>	<b>9.9</b>	<b>600</b>	<b>22.7</b>	4. その他の増加要因: 主にNORD社取得に伴い連結 調整勘定が363百万円増加
営業権	Goodwill	1,943	6.5	2,019	6.1	76	3.9	
その他	Other assets	699	2.3	1,223	3.7	524	75.0	
<b>投資その他の資産</b>	<b>Investments and other assets</b>	<b>3,608</b>	<b>12.0</b>	<b>3,288</b>	<b>10.0</b>	<b>△ 320</b>	<b>△ 8.9</b>	5. 投資有価証券の減少要因: 時価の上昇による増加 と、1年内償還予定社債296の流動資産への振替及び 売却による減少による
投資有価証券	Investment securities	1,558	5.2	1,376	4.2	△ 182	△ 11.7	
その他	Other assets	2,211	7.4	2,290	7.0	79	3.6	
貸倒引当金	Allowance for doubtful assets	△ 160	△ 0.5	△ 377	△ 1.1	△ 217	135.6	
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	<b>30,041</b>	<b>100.0</b>	<b>32,859</b>	<b>100.0</b>	<b>2,818</b>	<b>9.4</b>	

### 参考. 換算レート表

	03/9期		04/3期		04/9期		05/3期		05/9期	
	03/6	03/9	03/12	04/3	04/6	04/9	04/12	05/3	05/6	05/9
US\$	119.80	111.25	107.13	105.69	108.43	111.05	104.21	107.39	110.62	113.19
Singapore \$	68.12	64.37	62.94	62.91	63.21	65.69	63.55	65.19	65.58	66.96
RMB	14.43	13.45	12.94	12.75	13.09	13.41	12.49	12.94	13.31	13.98

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

### 3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3		05/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期末比 YOY	
<b>流動負債</b>	<b>Current liabilities</b>	<b>9,548</b>	<b>31.8</b>	<b>11,096</b>	<b>33.8</b>	<b>1,548</b>	<b>16.2</b>	1. 有利子負債の内容 短期借入金+1年内長期借入金 6,030(5,312)百万円 長期借入金+転換社債 5,693(5,414)百万円 合計 11,723(10,727)百万円 *カッコ内は05/3期末 単体合計 5,517百万円(前期末比 175百万円増) 2. 流動負債その他の増加要因:未払法人税、設備未払金145(主に杭州子会社)の増加による 3. 転換社債の発行条件 発行総額 23,000千スイス・フラン(SF) 固定為替換算レート 1SF=90.08円 発効日 '03/11/17 満期 '08/3/31 転換価格 796.20円 利率 0.125% 株式への転換率 5%
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	1,840	6.1	2,042	6.2	202	11.0	
短期借入金	Short-term borrowings	3,093	10.3	3,248	9.9	155	5.0	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borr.	2,219	7.4	2,781	8.5	562	25.3	
賞与引当金	Accrued corporation taxes	134	0.4	138	0.4	4	3.0	
その他	Other current liabilities	2,261	7.5	2,885	8.8	624	27.6	
<b>固定負債</b>	<b>Long-term liabilities</b>	<b>5,620</b>	<b>18.7</b>	<b>6,020</b>	<b>18.3</b>	<b>400</b>	<b>7.1</b>	
転換社債	Convertible bonds	1,776	5.9	1,776	5.4	0	0.0	
長期借入金	Long-term borrowings	3,637	12.1	3,916	11.9	279	7.7	
その他	Other long-term liabilities	205	0.7	325	1.0	120	58.5	
<b>負債合計</b>	<b>Total Liabilities</b>	<b>15,168</b>	<b>50.5</b>	<b>17,116</b>	<b>52.1</b>	<b>1,948</b>	<b>12.8</b>	
<b>少数株主持分</b>	<b>Minority interests</b>	<b>83</b>	<b>0.3</b>	<b>60</b>	<b>0.2</b>	<b>△ 23</b>	<b>△ 27.7</b>	
資本金	Common stock	6,910	23.0	6,910	21.0	0	0.0	
資本剰余金	Capital surplus	7,784	25.9	7,784	23.7	0	0.0	
利益剰余金	Profit surplus	762	2.5	1,009	3.1	247	32.4	
其他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	153	0.5	308	0.9	155	101.3	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	△ 661	△ 2.2	△ 170	△ 0.5	491	-	
自己株式	Treasury stock-at cost	△ 160	△ 0.5	△ 160	△ 0.4	0	-	
<b>資本合計</b>	<b>Total shareholders' equity</b>	<b>14,789</b>	<b>49.2</b>	<b>15,682</b>	<b>47.7</b>	<b>893</b>	<b>6.0</b>	
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity</b>	<b>30,041</b>	<b>100.0</b>	<b>32,859</b>	<b>100.0</b>	<b>2,818</b>	<b>9.4</b>	

#### \* 事業セグメントと製品区分 Business Segments and Product Lines

装置関連	Equipment related	電子デバイス	Electronic device	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	サーモモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン製品	Silicon related products	磁性流体・その他	Ferrofluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	基板実装	Surface mount chips		

#### 4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/9		05/9		前年同期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
<b>売上高</b>	<b>Net Sales</b>	<b>10,783</b>	<b>100.0</b>	<b>10,725</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 0.5</b>	<p>1. 事業セグメント別の状況</p> <p>(1) 装置関連: シリコン製品の太陽電池向けインゴットが伸長。EB-ガン、セラミック製品等も堅調。真空シール・部品及び石英製品は事業環境が厳しい中、予想以上に健闘。</p> <p>(2) 電子デバイス: 自動車温調シート、半導体製造装置、メディカル向けにサーモモジュールが増加するも、コンピュータシールの減少を補えず。</p> <p>(3) CMS: シリコンウェハー加工、装置部品洗浄、工作機械製造、太陽電池用単結晶引上装置等々が堅調に推移。</p> <p>2. 売上総利益の減少及び利益率悪化のポイント</p> <p>(1) コンピューターシールの大幅減収</p> <p>(2) FFB・HDD関連の先行投資負担</p> <p>(3) 真空シールにおける案件の小型化</p> <p>(4) プロダクトミックスの悪化</p> <p>(5) 原材料高</p> <p>3. 販管費増加要因</p> <p>(1) 連結子会社の増加</p> <p>(2) 円安による海外子会社経費の膨張</p> <p>4. 営業外損益</p> <p>主に親会社の債権・債務の為替評価及び中国子会社の円建て債務による為替差益の発生</p> <p>5. 特別損益の主な内容</p> <p>特別利益: 投資有価証券売却益149百万円、補償金収入600百万円</p> <p>特別損失: 貸倒引当金繰入額 224百万円、減損損失 43百万円</p>
売上原価	Cost of sales	7,366	68.3	7,805	72.8	6.0	
売上総利益	Gross profit	3,417	31.7	2,920	27.2	△ 14.5	
販管費	SG&A expenses	2,353	21.8	2,627	24.5	11.6	
<b>営業利益(A)</b>	<b>Operating Income</b>	<b>1,063</b>	<b>9.9</b>	<b>292</b>	<b>2.7</b>	<b>△ 72.5</b>	
営業外収益	Other income	236	2.2	275	2.6	16.5	
受取利息・配当金	Interest & Dividend Income	26	0.2	32	0.3	23.1	
出資金評価益	Investment evaluation profit	-	-	16	0.1	-	
賃貸収入	Lease income	11	0.1	33	0.3	200.0	
為替差益	Foreign exchange gain	121	1.1	130	1.2	7.4	
その他	Other income	75	0.8	62	0.7	△ 17.3	
営業外費用	Other expense	359	3.3	314	2.9	△ 12.5	
支払利息	Interest expense	151	1.4	146	1.4	△ 3.3	
出資金評価損	Loss on devaluation of investments	0	0.0	-	-	-	
たな卸資産評価損	Loss on devaluation of Inventories	46	0.4	93	0.9	102.2	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	99	0.9	10	0.1	△ 89.9	
為替差損	Foreign exchange loss	-	-	-	-	-	
その他	Other expense	61	0.6	64	0.6	4.9	
<b>経常利益</b>	<b>Recurring income</b>	<b>940</b>	<b>8.7</b>	<b>253</b>	<b>2.4</b>	<b>△ 73.0</b>	
特別利益	Extraordinary gain	72	0.7	784	7.3	988.9	
特別損失	Extraordinary loss	282	2.6	272	2.5	△ 3.5	
<b>税前利益</b>	<b>Income before taxes</b>	<b>729</b>	<b>6.8</b>	<b>766</b>	<b>7.1</b>	<b>5.1</b>	
法人税等	Income tax (current)	243	2.3	376	3.5	54.7	
同 調整額	Income tax (deferred)	6	0.1	4	0.0	△ 33.3	
少数株主利益	Minority interest	21	0.2	△ 24	△ 0.2	-	
<b>当期利益</b>	<b>Net income</b>	<b>458</b>	<b>4.2</b>	<b>410</b>	<b>3.8</b>	<b>△ 10.5</b>	
設備投資	Capital expenditures	1,163		1,374			主に、杭州子会社の第2工場、真空シール、石英加工設備及びCMS事業に関わる設備投資であります
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	650		690			
研究開発費	R&D expenses	46		60			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,713		982			
1株利益(円)	EPS(yen)	26.8		20.6			
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	100.1		49.3			
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	0.0		0.0			
期末従業員数(人)	Number of employees	3,467		3,653			

## 5. 連結セグメント別売上高・営業利益 Segment Information (Consolidated)

### 事業別 Operations in Business Segments

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period		05/3上	05/3下	05/3通期	構成比	前期比	06/3上	前年同期比	06/3下	前年同期比	06/3通期	構成比	前期比
製品 Product Lines		1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	YOY	1st Half	YOY	2nd Half	YOY	Year Ended	Share	YOY
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	2,052	2,162	4,214	20.0	△ 3.2	2,030	△ 1.1	2,272	5.1	4,302	18.7	2.1
石英製品	Quartz	2,094	2,206	4,300	20.4	15.9	1,910	△ 8.8	1,891	△ 14.3	3,801	16.5	△ 11.6
シリコン製品	Silicon related products	497	603	1,100	5.2	—	657	32.2	943	56.4	1,600	7.0	45.5
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	696	893	1,589	7.5	△ 0.8	881	26.6	838	△ 6.2	1,719	7.5	8.2
<b>装置関連</b>	<b>Equipment Related</b>	<b>5,339</b>	<b>5,864</b>	<b>11,203</b>	<b>53.1</b>	<b>15.6</b>	<b>5,478</b>	<b>2.6</b>	<b>5,944</b>	<b>1.4</b>	<b>11,422</b>	<b>49.7</b>	<b>2.0</b>
コンピュータシール	Computer Seals	697	315	1,012	4.8	△ 14.0	83	△ 88.1	67	△ 78.7	150	0.7	△ 85.2
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,128	926	2,054	9.7	42.1	1,049	△ 7.0	1,450	56.6	2,499	10.9	21.7
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	290	222	512	2.4	△ 45.3	291	0.3	253	14.0	544	2.4	6.3
<b>電子デバイス</b>	<b>Electronic devices</b>	<b>2,116</b>	<b>1,461</b>	<b>3,578</b>	<b>17.0</b>	<b>△ 15.2</b>	<b>1,423</b>	<b>△ 32.8</b>	<b>1,770</b>	<b>21.1</b>	<b>3,193</b>	<b>13.9</b>	<b>△ 10.8</b>
受託生産	CMS	3,328	2,997	6,325	30.0	100.8	3,824	14.9	4,560	52.2	8,384	36.5	32.6
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>10,783</b>	<b>10,322</b>	<b>21,105</b>	<b>100.0</b>	<b>16.8</b>	<b>10,725</b>	<b>△ 0.5</b>	<b>12,275</b>	<b>18.9</b>	<b>23,000</b>	<b>100.0</b>	<b>9.0</b>

装置関連	Equipment related	692	682	1,374	78.0	267.4	451	△ 34.8					
電子デバイス	Electronic devices	316	△ 71	245	13.9	△ 48.9	△ 233	—					
受託生産	CMS	75	106	181	10.3	—	94	25.3					
全社	All	△ 21	△ 18	△ 37	△ 2.1	—	△ 19	—					
<b>営業利益合計</b>	<b>Operating Income</b>	<b>1,063</b>	<b>699</b>	<b>1,762</b>	<b>100.0</b>	<b>185.0</b>	<b>292</b>	<b>△ 72.5</b>	<b>1,108</b>	<b>58.5</b>	<b>1,400</b>		<b>△ 20.5</b>

※ご参考 営業利益

## 6. 期初計画と実績との差異 Review in the first half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/9計画(A)		05/9実績(B)			コメント
		Original plan		Achievement			
		金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	計画比 B/A	
<b>売上高</b>	<b>Net Sales</b>	<b>10,100</b>	<b>△ 6.3</b>	<b>10,725</b>	<b>△ 0.5</b>	<b>6.2</b>	1. 連結売上高 期初計画が保守的であった事及び装置関連で小型案件が予想以上に増加した事等で、3セグメントいずれも計画を超過。
売上原価	Cost of sales	7,090	△ 3.7	7,805	6.0	10.1	
売上総利益	Gross profit	3,010	△ 11.9	2,920	△ 14.5	△ 3.0	
販管費	SG&A expenses	2,670	13.5	2,627	11.6	△ 1.6	
<b>営業利益</b>	<b>Operating Income</b>	<b>340</b>	<b>△ 68.0</b>	<b>292</b>	<b>△ 72.5</b>	<b>△ 14.1</b>	
営業外損益	Other income & expense	△ 170	-	△ 39	-	-	2. 売上総利益: FFBの先行投資負担及び装置関連での案件の小型化、及び原材料高による。
<b>経常利益</b>	<b>Recurring income</b>	<b>170</b>	<b>△ 81.9</b>	<b>253</b>	<b>△ 72.9</b>	<b>48.8</b>	
特別損益	Extraordinary gain & loss	△ 40	-	512	-	-	3. 販管費: 予想以上に進んだ円安の影響を経費節減で吸収、計画を下回った。
<b>税引前利益</b>	<b>Income before taxes</b>	<b>130</b>	<b>△ 82.2</b>	<b>766</b>	<b>5.1</b>	<b>489.2</b>	
法人税等	Income tax & others	40	△ 85.2	356	31.9	790.0	4. 営業外損益: 想定以上の円安水準で推移。
<b>中間当期利益</b>	<b>Net income</b>	<b>90</b>	<b>△ 80.3</b>	<b>410</b>	<b>△ 10.5</b>	<b>355.6</b>	

## 事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		05/9計画(A)		05/9実績(B)			コメント
製品	Product Lines	Original plan		Achievement			
		金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	計画比 B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,990	△ 3.0	2,030	△ 1.1	2.0	1. 装置関連 (1)真空シール: 米国半導体投資の落ち込みを国内メーカーのLCD・PDP投資がカバー。 (2)石英製品: 300mmウエーハ向けが順調、下期分の前倒しも一因。 (3)EB-ガン・その他: セラミックス製品が好調に推移
石英製品	Quartz	1,767	△ 15.6	1,910	△ 8.8	8.1	
シリコン製品	Silicon products	659	32.6	657	32.2	△ 0.3	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	771	10.8	881	26.6	14.3	2. 電子デバイス サーモモジュール: 半導体コータデベロッパ・メディカル向けの好調に。
<b>装置関連</b>	<b>Equipment related</b>	<b>5,187</b>	<b>△ 2.8</b>	<b>5,478</b>	<b>2.6</b>	<b>5.6</b>	
コンピュータシール	Computer Seals	91	△ 86.9	83	△ 88.1	△ 8.8	3. CMS事業 装置部品洗浄及び工作機械製造、太陽電池用単結晶引上装置等が堅調に推移した事による。
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	933	△ 17.3	1,049	△ 7.0	12.4	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	270	△ 6.9	291	0.3	7.8	
<b>電子デバイス</b>	<b>Electronic devices</b>	<b>1,294</b>	<b>△ 38.8</b>	<b>1,423</b>	<b>△ 32.8</b>	<b>10.0</b>	
受託生産	CMS	3,619	8.7	3,824	14.9	5.7	
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>10,100</b>	<b>△ 6.3</b>	<b>10,725</b>	<b>△ 0.5</b>	<b>6.2</b>	



## 7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3		06/3e		前期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	21,105	100.0	23,000	100.0	9.0	下期為替レート: 1ドル=110円 1. 売上高 シリコン製品、サーモジュール、CMSの伸長を見込む。 2. 売上総利益: プロダクトミックスの悪化等上期と同様の要因による。 3. 販管費: 経費削減を継続するも、グループ企業が増加及び円安等による。 4. 営業外損益 (1) 支払利息310百万円程度を見込む (2) 為替は差益・差損とも見込まず。 5. 特別損益 特別利益: 下期においては見込まず 特別損失: コンピュータシール設備の廃棄、その他予定は無いが下期に計300百万円程度見込
売上原価	Cost of sales	14,423	68.3	16,395	71.3	13.7	
売上総利益	Gross profit	6,682	31.7	6,605	28.7	△ 1.2	
販管費	SG&A expenses	4,920	23.3	5,205	22.6	5.8	
営業利益(A)	Operating Income	1,762	8.3	1,400	6.1	△ 20.5	
営業外損益	Other income	△ 306	△ 1.4	△ 200	△ 0.9	-	
経常利益	Recurring income	1,456	6.9	1,200	5.2	△ 17.6	
特別利益	Extraordinary gain	212	1.0	785	3.4	270.3	
特別損失	Extraordinary loss	458	2.2	585	2.5	27.7	
税前利益	Income before taxes	1,210	5.7	1,400	6.1	15.7	
法人税等	Income tax & others	577	2.7	700	3.0	21.3	
当期利益	Net income	633	3.0	700	3.0	10.6	
設備投資	Capital expenditures	2,073		3,000			主な設備投資内容は、上期に投資した物を含み、杭州子会社の第2工場設備、真空シール、石英製造設備、上海子会社(漢虹)での新工場建設、太陽電池用単結晶引上装置製造を含む、工作機械製造設備等であり、ます。
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,359		1,400			
研究開発費	R&D expenses	109		200			
EBITDA(A+B)	Cash flows	3,121		2,800			
1株当たり利益(円)	EPS(yen)	35.15		35.15			
1株当たりEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	156.70		140.59			
1株当たり配当(単体、円)	DPS(yen)	8.00		8.00			
期末従業員数(人)	Number of employees	3,323		3,653			

### \* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

		05/3			06/3e		
		単独(A)	連結(B)	連単倍率	単独(A)	連結(B)	連単倍率
		Non Consoli.	Consoli.	(A)/(B)	Non Consoli.	Consoli.	(A)/(B)
売上高	Net Sales	8,927	21,105	2.4	11,300	23,000	2.0
営業利益	Operating Income	352	1,762	5.0	200	1,400	7.0
経常利益	Recurring income	645	1,456	2.3	550	1,200	2.2
当期利益	Net income	230	633	2.8	450	700	1.6

## 8. 期初計画と修正計画との差異(下期) Outline of the revised plan (The second half)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	06/3下期 期初計画(A)		06/3下期 修正計画(B)			コメント
		Original plan		Revised plan		計画比	
		金額 Mil.Yen	前年同期比 yoy	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY		
売上高	Net Sales	12,300	19.2	12,275	18.9	△ 0.2	1. 連結売上高: 足下堅調、売上面では下期も特に不安なし。 2. 売上総利益: 上期要因に加え、CMSの構成比上昇による。 3. 販管費: 円安・子会社増はあるものの、経費削減を継続。
売上原価	Cost of sales	8,310	17.8	8,590	21.7	3.4	
売上総利益	Gross profit	3,990	22.2	3,685	12.9	△ 7.6	
販管費	SG&A expenses	2,530	△ 1.4	2,578	0.4	1.9	
営業利益	Operating Income	1,460	108.9	1,108	58.5	△ 24.1	
営業外損益	Other income	△ 130	-	△ 161	-	-	
経常利益	Recurring income	1,330	157.8	947	83.5	△ 28.8	
特別損益	Extraordinary gain	△ 205	-	△ 313	-	-	
税引前利益	Income before taxes	1,125	133.9	634	31.8	△ 43.6	
法人税等	Income tax & others	514	68.5	344	12.8	-	
当期利益	Net income	610	248.6	290	65.7	△ 52.5	

### 事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		06/3下期 期初計画(A)		06/3下期 修正計画(B)			コメント
製品	Product type	Original plan		Revised plan		計画比	
		金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY		
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	2,210	2.2	2,272	5.1	2.8	1. 装置関連 (1) 石英製品: 上期前倒し納品の影響等。 (2) シリコン製品: 太陽電池向けシリコンインゴットを上方修正。 (3) EB-ガンその他: 上期前倒し納品の影響等。
石英製品	Quartz	2,205	△ 0.0	1,891	△ 14.3	△ 14.2	
シリコン製品	Silicon products	612	1.5	943	56.4	54.1	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,036	16.0	838	△ 6.2	△ 19.1	2. 電子デバイス サーモモジュール: 自動車温調シート向けの回復
装置関連	Equipment related	6,063	3.4	5,944	1.4	△ 2.0	
コンピュータシール	Computer Seals	67	△ 78.7	67	△ 78.7	0.0	3. CMS事業 ウエーハ加工設備の設置時期によるズレ
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,289	39.2	1,450	56.6	12.5	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	252	13.5	253	14.0	0.4	
電子デバイス	Electronic devices	1,609	10.1	1,770	21.1	10.0	
受託生産	CMS	4,628	54.4	4,560	52.2	△ 1.5	
売上高合計	Total Sales	12,300	19.2	12,275	18.9	△ 0.2	

9. 期初計画と修正計画との差異(通期) Outline of the revised plan (The accounting period)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	06/3通期 期初計画(A)		06/3通期 修正計画(B)			コメント
		Original plan		Revised plan			
		金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	22,400	6.1	23,000	9.0	2.7	1. 連結売上高: 上期計画超過分を上乗せ 2. 売上総利益: 期初計画プロダクトミックスとの相違による。 3. 販管費特筆すべき増減要因はなく、ほぼ期初計画での着地を予想。
売上原価	Cost of sales	15,400	6.8	16,395	13.7	6.5	
売上総利益	Gross profit	7,000	4.8	6,605	△ 1.2	△ 5.6	
販管費	SG&A expenses	5,200	5.7	5,205	5.8	0.1	
営業利益(A)	Operating Income	1,800	2.2	1,400	△ 20.5	△ 22.2	
営業外損益	Other income	△ 300	-	△ 200	-	-	
経常利益	Recurring income	1,500	3.0	1,200	△ 17.6	△ 20.0	
特別利益	Extraordinary gain	0	△ 100.0	785	270.3	-	
特別損失	Extraordinary loss	245	△ 46.5	585	27.7	138.8	
税前列益	Income before taxes	1,254	3.6	1,400	15.7	11.6	
法人税等	Income tax & others	554	△ 4.0	700	21.3	26.4	
当期利益	Net income	700	10.6	700	10.6	0.0	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		06/3通期 期初計画(A)		06/3通期 修正計画(B)			コメント
製品	Product type	Original plan		Revised plan			
		金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	計画比 B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	4,200	△ 0.3	4,302	2.1	2.4	1. 装置関連: セグメント全体ではほぼ計画通り (1) 石英製品: 足元の受注は好調だが売上は来期にずれ込み (2) シリコン製品: 太陽電池向けシリコンインゴットを上方修正。 セラミックス製品は、今後も好調が見込め事業として大きくなると期待 2. 電子デバイス サーモジュール: 上期の好調に加え、自動車シート向けの回復 3. CMS事業: 通期ではほぼ計画通りの見込み。
石英製品	Quartz	3,972	△ 7.6	3,801	△ 11.6	△ 4.3	
シリコン製品	Silicon products	1,271	15.5	1,600	45.5	25.9	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,807	13.7	1,719	8.2	△ 4.9	
装置関連	Equipment related	11,250	0.4	11,422	2.0	1.5	
コンピュータシール	Computer Seals	158	△ 84.4	150	△ 85.2	△ 5.1	
サーモジュール	Thermo-electric Modules	2,222	8.2	2,499	21.7	12.5	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	522	2.0	544	6.3	4.2	
電子デバイス	Electronic devices	2,903	△ 18.9	3,193	△ 10.8	10.0	
受託生産	CMS	8,247	30.4	8,384	32.6	1.7	
売上高合計	Total Sales	22,400	6.1	23,000	9.0	2.7	

## 10. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	04/9	05/3	05/9	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	729	1,210	766	
減価償却費 Depreciation and Amortization	650	1,359	690	
為替差損益 Net loss or gain on foreign exchange	△ 126	△ 49	△ 77	
売上債権の増減額 Changes in Notes and accounts receivable	△ 932	△ 845	396	
たな卸資産の増減額 Changes in Inventories	△ 228	△ 180	△ 256	
仕入債務の増減額 Changes in Notes and accounts payable	465	△ 2	69	
その他 Others	512	656	△ 347	04/9 05/3 05/9 連調勘定償却 210百万円 233百万円 20百万円 貸倒引当金増減額 29百万円 152百万円 171百万円
<b>I. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities</b>	<b>1,070</b>	<b>2,149</b>	<b>1,241</b>	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	△ 1,100	△ 2,324	△ 900	
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of tangible fixed assets	90	383	43	
投資有価証券、有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	△ 7	△ 93	△ 20	
投資有価証券、有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	146	305	335	
その他 Others	△ 82	△ 620	△ 787	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 04/9 - 05/3 - 05/9 △498百万円(NORD社)
<b>II. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities</b>	<b>△ 953</b>	<b>△ 2,349</b>	<b>△ 1,329</b>	
短期借入金の増減額 Change in Short-term borrowing	555	△ 55	36	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt	603	1,497	2,112	長期借入れの主な実績 フェローテック:1,700百万円 上海:350百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term debt	△ 1,274	△ 3,096	△ 1,344	長期借入金の主な返済実績 フェローテック:825百万円 上海158百万円 杭州97百万円
配当金の支払額 Payments for dividend	△ 135	△ 135	△ 164	
その他 Others	0	2,062	△ 1	株式の発行による収入 04/9 - 05/3 2,049百万円 05/9 -
<b>III. 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from Financing activities</b>	<b>△ 251</b>	<b>273</b>	<b>639</b>	
<b>IV. 現金及び現金等価物の中間期末残高 Cash &amp; Cash Equivalent</b>	<b>2,973</b>	<b>3,188</b>	<b>3,759</b>	

### 11. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product

#### (1)売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated						
	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3e	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	715	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	3,105	4,214	4,302
石英製品	Quartz	665	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	2,658	4,300	3,801
シリコン製品	Silicon products	—	—	—	—	—	—	821	1,100	1,600
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	1,503	2,134	1,349	1,338	1,589	1,719
<b>装置関連</b>	<b>Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>1,380</b>	<b>2,430</b>	<b>3,753</b>	<b>10,273</b>	<b>9,115</b>	<b>6,851</b>	<b>7,921</b>	<b>11,203</b>	<b>11,422</b>
コンピュータシール	Computer Seals	3,086	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,363	1,012	150
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	305	410	591	1,150	893	1,110	1,577	2,054	2,499
ハードディスク関連	HDD products	179	502	828	880	467	332	—	—	—
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	208	385	966	1,547	1,421	1,243	680	512	544
<b>電子デバイス</b>	<b>Electric devices</b>	<b>3,778</b>	<b>3,884</b>	<b>4,970</b>	<b>6,162</b>	<b>4,990</b>	<b>4,270</b>	<b>3,619</b>	<b>3,578</b>	<b>3,193</b>
受託生産	CMS	—	—	—	—	670	1,722	3,458	6,325	8,384
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>5,158</b>	<b>6,314</b>	<b>8,723</b>	<b>16,435</b>	<b>14,775</b>	<b>12,845</b>	<b>15,000</b>	<b>21,105</b>	<b>23,000</b>

\* 受託生産(CMS)は03/3期から決算短信等で独立表示しております。

#### (2)前期比 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated						
	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3e	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	△ 34.7	86.6	63.5	—	△ 22.9	△ 18.4	△ 3.2	35.7	2.1
石英製品	Quartz	—	—	43.4	—	△ 16.9	△ 24.8	15.9	61.8	△ 11.6
シリコン製品	Silicon products	—	—	—	—	—	—	—	34.0	45.5
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	42.0	△ 36.8	△ 0.8	18.8	8.2
<b>装置関連</b>	<b>Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>26.0</b>	<b>76.1</b>	<b>54.4</b>	<b>—</b>	<b>△ 11.3</b>	<b>△ 24.8</b>	<b>15.6</b>	<b>41.4</b>	<b>2.0</b>
コンピュータシール	Computer Seals	39.6	△ 16.2	△ 0.1	—	△ 14.5	△ 28.2	△ 14.0	△ 25.8	△ 85.2
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	△ 25.6	34.4	44.1	—	△ 22.3	24.3	42.1	30.2	21.7
ハードディスク関連	HDD products	△ 62.8	180.4	65.0	—	△ 46.9	△ 28.9	—	—	—
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	△ 54.9	85.1	150.8	—	△ 8.1	△ 12.5	△ 45.3	△ 24.7	6.3
<b>電子デバイス</b>	<b>Electric devices</b>	<b>6.0</b>	<b>2.8</b>	<b>28.0</b>	<b>—</b>	<b>△ 19.0</b>	<b>△ 14.4</b>	<b>△ 15.2</b>	<b>△ 1.1</b>	<b>△ 10.8</b>
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	—	100.8	82.9	32.6
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>10.7</b>	<b>22.4</b>	<b>38.2</b>	<b>—</b>	<b>△ 10.1</b>	<b>△ 13.1</b>	<b>16.8</b>	<b>40.7</b>	<b>9.0</b>

#### (3)構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated			連結 Consolidated						
	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3e	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	13.9	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	20.7	20.0	18.7
石英製品	Quartz	—	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	17.7	20.4	16.5
シリコン製品	Silicon products	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	7.0
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	14.4	10.5	8.9	7.5	7.5
<b>装置関連</b>	<b>Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>—</b>	<b>38.5</b>	<b>43.0</b>	<b>62.5</b>	<b>61.7</b>	<b>53.3</b>	<b>52.8</b>	<b>53.1</b>	<b>49.7</b>
コンピュータシール	Computer Seals	59.8	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	9.1	4.8	0.7
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	5.9	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	10.5	9.7	10.9
ハードディスク関連	HDD products	3.5	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	—	—	—
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	4.0	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	4.5	2.4	2.4
<b>電子デバイス</b>	<b>Electric devices</b>	<b>73.2</b>	<b>61.5</b>	<b>57.0</b>	<b>37.5</b>	<b>33.8</b>	<b>33.2</b>	<b>24.1</b>	<b>17.0</b>	<b>13.9</b>
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	13.4	23.1	30.0	36.5
<b>売上高合計</b>	<b>Total Sales</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>